高機能絶縁
フィルムレポート
-2015-

ー調査のポイントー

回路基材として用いられるフィルムを調査対象として、
主にリジッド/フレキシブルに分類し、各種材料別の
技術・市場動向を調査・分析しています。

◆発刊日 ： 2015年9月30日
◆サイズ／ページ数 ： A4判／95頁
◆価格（税別）98,000円（レポートのみ）

〒103-0004　東京都中央区東日本橋3-10-14　サンライズ橘2F
株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ
TEL：03-5641-2871　FAX：0120-052-807
URL) http://www.jms21.co.jp

第1章 総論

1.高機能絶縁フィルムの市場規模予測 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2.各フィルムの市場動向 ・・4
（1）層間絶縁フィルム
（2）高速/高周波フィルム
（3）ポリイミドフィルム
（4）LCPフィルム
（5）PENフィルム
（6）放熱用フィルム
3.主要企業の販売状況 ・・・6

第2章 各種絶縁フィルムの動向

A リジッド系

1. 層間絶縁フィルム ・・8
1-1 製品概要
1-2 応用分野市場 ・・・9
（1）ICパッケージ基板の概要
（2）ICパッケージ基板の業界概要
（3）層間絶縁フィルムを採用したICパッケージ基板の市場規模推移と予測
（4）層間絶縁フィルムを採用したICパッケージ基板のメーカ別シェア（2013）
（5）層間絶縁フィルムを採用したICパッケージ基板の技術動向
1-3 ICパッケージ基板用層間絶縁フィルムの動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
（1）ICパッケージ基板における基材の採用状況
（2）参入企業一覧及び各社の事業動向
（3）各社製品の比較
（4）販売実績（2013年～2014年）
（5）ICパッケージ基板用層間絶縁フィルムの技術・開発動向
2. 高周波/高速用フィルム ・・21
2-1 調査対象製品/定義
2-2 主要な高周波/高速用フィルムの製品仕様/特性
2-3 高周波/高速用フィルムの応用分野と高周波基板の層数タイプ
2-4 高周波/高速用フィルムの採用検討の事例
2-5 高周波/高速用フィルムの市場規模（2014年）
2-6 高周波/高速用フィルムの市場規模推移予測

B フレキシブル系

1業界概要 ・・25
1-1 業界全体
1-2 フィルムメーカの参入状況
1-3 応用分野市場
1-3-1 FPCにおける基材の採用状況
1-3-2 FCCLのメーカ別シェア（2013年実績）
1-3-3 FPCのメーカ別シェア（2014年）
1-3-4 応用分野別FPCの市場規模推移と予測

2. FPC用フィルムの動向 ･･･ 36
2-1 ポリイミドフィルムの概要
2-2 ポリイミドフィルムの種類
2-3 全体販売実績（2013年～2014年）
2-4 応用分野別販売実績（2014年）
2-5 ポリイミドフィルムの市場規模予測（応用分野別）
3 LCPフィルム ･･･ 45
3-1 LCPの概要
3-2 LCPフィルムの製法
3-2-1 全芳香族ポリエステル
3-2-2 全芳香族アミド（アラミド）
3-3 LCPフィルムの特性
3-4 LCPフィルムの業界構造・参入メーカ
3-4-1 LCPフィルムの参入メーカ
3-5 LCPフィルムの用途及び製品概要
3-6 LCPの価格動向
3-7 各社製品の比較
3-7-1 スペック（クラレ）
3-7-2 スペック（プライマテック）
3-8 LCPフィルムの市場動向2013、2014（FCCL向けのみ）
3-9 LCPフィルムの市場規模需要予測（2013年～2020年）
4.PENフィルム ･･･54
4-1 PENフィルム製品の調査対象と製品概要
1）調査対象製品
2）PEN樹脂/PENフィルム/FCCL材料（PEN）の参入メーカ
3）PENフィルムの用途
4-2 ポリエチレンナフタレート（PEN）フィルムの製品の特性（PET/PIとの比較表）
4-3 ポリエチレンナフタレート（PEN）フィルムのメーカシェア（2014年）
4-4 ポリエチレンナフタレート（PEN）フィルムの応用分野別市場内訳（2014年）
4-5 ポリエチレンナフタレート（PEN）フィルムの市場規模推移予測
4-6 ポリエチレンナフタレート（PEN）フィルムの価格帯
4-7 ポリエチレンナフタレート（PEN）フィルムの供給関係
4-8 ポリエチレンナフタレート（PEN）フィルムの技術・開発動向
5. 放熱基板用フィルム ･･ 61
5-1 放熱基板用フィルム製品の調査対象と製品概要
5-2 放熱基板用フィルムの参入メーカ/製品名/製品タイプ
5-3 主要な放熱基板用フィルムの仕様・特性
5-4 放熱基板用フィルムのメーカシェア（2014年）
5-5 放熱基板用フィルムの市場規模推移予測
5-6 放熱基板用フィルムの価格帯
5-7 放熱基板用フィルムの技術・開発動向

第3章 フィルムメーカ事例研究
味の素ファインテクノ / カネカ / クラレ / 住友ベークライト / 積水化学工業 / 帝人デュポンフィルム / 東レデュポン / 日本ゼオン / 日立化成 / プライマテック / SKCKOLONPI / TAIMIDE TECH

■申込要項

▼申込方法：
　巻末の申込書に所定事項をご記入の上、弊社宛までFAXお願いいたし ます。
▼お支払について：
　申込時に請求書を発行いたしますので、請求日の翌月末日までに弊社 指定口座にお振込みお願い申し上げます。

申　込　書

年　　月　　日

FAX：0120-052-807

㈱ジャパンマーケティングサーベイ　行

□高機能絶縁フィルムレポート-2015-（書籍のみ）

企業名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

担当者：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　所属：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　役職：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　E-mail address：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

住所：（〒　　ー　　）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

TEL：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

FAX：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿